



# 中国硅酸盐学会测试技术分会

中国硅酸盐学会测试技术分会由中华人民共和国民政部于2009年11月批准登记成立。分会是全国无机材料检测工作者的一个合作交流平台，旨在推动我国在无机材料测试与评价技术方面的研究及应用的发展。分会的主要工作包括：组织举办各类学术会议或论坛；开展相关咨询服务；推广和宣传新产品新技术等。本网页主要发布由测试技术分会主办的学术年会——无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会（前身为全国无机材料测试与评价学术年会）信息，敬请关注。

## 第五届无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会 (TEIM2014)

2014.04.23 ~ 04.25 贵州省 贵阳市

会议秘书处  
[teim@ccs-cicc.com](mailto:teim@ccs-cicc.com)

[欢迎词](#)

[参会基本流程](#)

[加入邮件列表](#)

[会议最新通知](#)

[会议基本信息](#)

[参会费用概述](#)

[提交论文摘要](#)

[提交论文全文](#)

[会议注册办法](#)

[会议报到通知](#)

[会议住宿预订](#)

[历届年会回顾](#)

[分会理事名单](#)

[返回首页](#)

第四届无机材料测试与评价学术年会 (TEIM2013) 已经顺利结束  
TEIM2013后续信息将集中发布于[会议最新通知](#)网页，敬请关注

### 欢迎词

中国硅酸盐学会测试技术分会（以下简称测试分会）诚邀国内同行出席一年一度的无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会（前身为全国无机材料测试与评价学术年会）。

自2009年批准成立以来，作为分会的主要活动之一，测试分会每年举办一次全国性学术年会——无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会（简称TEIM年会），力求通过几年的努力，将这个学术年会办成无机材料检测工作者的一个重要的学术交流平台，从而推进我国在无机材料测试与评价技术方面的研究及应用的不断发展。

每一届 TEIM年会都将邀请若干位在无机材料检测方面具有较高学术造诣的国内知名专家做大会主题报告，邀请十位左右国内知名中青年学者做邀请报告。测试分会欢迎国内同行随时推荐或自荐大会主题报告或邀请报告人选。

每一届 TEIM年会都将设置一般口头报告、论文展示、企业展示等环节，采取多种形式以增强会议的交流效果，达到会议的预期目的。

每一届TEIM年会都将在实地考察的基础上，选择并委托会议举办地有资质的会议服务公司或酒店承办，以确保会议期间为所有与会代表提供高质量的后勤服务。

测试分会与瑞士 TTP 出版公司之间形成了良好的合作关系。每一届TEIM年会的论文集都将在会后半年左右由 TTP 出版公司在其旗下的期刊上发表。目前，发表TEIM年会论文集的 TTP 期刊（一般为 *Key Engineering Materials*）是工程索引 (EI) 和国际会议录索引 (ISTP) 源期刊（请仔细阅读[关于 EI 收录的几点说明](#)）。

为保证与会代表与会议秘书处之间的信息沟通，会议秘书处专用电子邮件 [teim@ccs-cicc.com](mailto:teim@ccs-cicc.com) 将长年有效。此外，会议秘书处也将通过中国硅酸盐学会特陶分会会议专用信箱 [ccs-cicc@vip.163.com](mailto:ccs-cicc@vip.163.com) 不定期发送会议有关通知。

测试分会衷心希望国内从事无机材料研究、开发工作的专家、学者、学生及工程技术人员关心、支持并踊跃出席无机材料结构、性能及测试表征技术研讨会，共同努力打造一个属于我们自己的高水平学术交流与合作平台。

友情邀请  
[加入会议邮件列表](#)  
及时收取会议的最新通知

TEIM2014即日起开始征文  
第一轮征文截止日期  
2014年2月25日

TEIM2014论文集将于会后以 *Key Engineering Materials* 专辑形式出版。目前，该期刊为 EI 和 ISTP 源期刊。

主办  
中国硅酸盐学会  
测试技术分会

承办  
中科院上海硅酸盐研究所  
上海应用技术学院  
清华大学

与会议相关的所有垂询请联系  
[龚江宏 博士](#)

[teim@ccs-cicc.com](mailto:teim@ccs-cicc.com)

